

113 年「半導體產業職能深化課程研習營」

課程日期：113 年 8 月 19 日~113 年 8 月 23 日

課程地點：龍華科技大學半導體工程系電腦教室(H303)暨實驗場域

課程時間：09:00-18:00 (報到時間 08:45-09:00；中午休息時間 12:00-13:00)

課程人數：25 人實體上課

參加資格：全國高中職學生，依報名先後順序錄取，主辦單位會另行通知。

備註:本次研習課程為期 3 天，需參與 7 成以上課程，將於課程結束後核發研習時數證明。

課程內容：

日期	時間	課程名稱	課程內容	授課教師	課程地點
第一天 8/19(一)	09:00-09:30	課程說明		龍華科技大學半導體工程系 江建志助理教授兼主任	H303
	09:30-12:00	半導體基礎入門	半導體基礎理論介紹	龍華科技大學半導體工程系 陳信良助理教授副主任	
	13:00-16:00	半導體產業介紹	國內外半導體產業與元件製程介紹	龍華科技大學半導體工程系 張勤煜助理教授	
	16:00-17:00	本校特色實作場域參觀	1.半導體製程中心 2.半導體檢測中心 3.半導體封裝及測試場域	龍華科技大學半導體工程系 李九龍教授	
	17:00-18:00	Q&A			H303
第二天 8/20(二)	09:00-12:00	功率半導體介紹	功率半導體產業、製程及應用介紹	亞昕科技公司大武崙廠 王星凱	H303
	13:00-16:00	半導體製程基礎理論介紹	氧化製程/膜厚量測、擴散製程/電性量測、氧化層蝕刻	龍華科技大學半導體工程系 陳信良助理教授副主任	H303
	16:00-17:00	本校特色實作場域參觀	1. 3D 數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠 2. 智慧製造類工廠實驗室	龍華科技大學半導體工程系 李九龍教授	
	17:00-18:00	Q&A			H303
第三天 8/21(三)	09:00-12:00	半導體微影製程實作	正負光阻實作、曝光製程、顯影製程	龍華科技大學半導體工程系 江建志助理教授兼副主任	H301
	13:00-16:00	半導體封裝材料概論	國內外半導體封裝測試產業與製程介紹	龍華科技大學半導體工程系 江建志助理教授兼副主任	H303
	16:00-17:00	本校特色實作場域參觀	1. 5G 行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠 2. 高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地	龍華科技大學半導體工程系 李九龍教授	
	17:00-18:00	結業式	1.心得分享 2.賦歸		H303

活動聯絡人:教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學產學合作處/賴建成專員

連絡電話:(02)2771-2171 分機 6020，E-mail：lks@mail.ntut.edu.tw